

## 新股深圳市大族數控科技股份有限公司 IPO 報告分析

### 一、公司概況

#### 1.1 新股基本資訊

- 股份代號：3200.HK
- 全球發售：發行 50,451,800 股 H 股，集資 4833.28 百萬港元
- 香港公開發售：發售 5,045,200 股 H 股，占全球發售總量約 10%
- 招股價：≤95.8 港元
- 每手股數：100 股
- 入場費：9,676.61 港元
- 公開發售日期：2026 年 01 月 29 日至 2026 年 02 月 03 日
- 分配結果日：2026 年 02 月 04 日
- 暗盤日：2026 年 02 月 05 日
- 上市日期：2026 年 02 月 06 日
- 保薦人：中金公司

#### 1.2 企業簡介

大族數控是中國領先的 PCB 專用生產設備解決方案服務商。公司於 PCB 專用設備行業經營，為各種下遊行業的核心基礎設施供應商。根據灼識諮詢的資料，公司的產品組合覆蓋鑽孔、曝光、壓合、成型及檢測等幾乎所有 PCB 生產主要工序。公司專注於打造行業價值鏈條，以高質量產品為客戶提供綜合解決方案。公司的客戶涵蓋 2024 年 Prismark 全球 PCB 企業百強排行榜 80% 的企業。憑借領先的研發技術、立體化的產品矩陣和穩定的客戶合作關係，自 2009 年以來，按收入計，公司已連續 16 年位列 CPCA 專用設備和儀器榜單第一名。根據灼識諮詢的資料，按 2024 年收入計，公司是中國最大的 PCB 專用生產設備製造商，中國市佔率為 10.1%。

#### 1.3 基石投資者

基石投資者包括宏興國際、GIC Private Limited、Schroders、HHLRA、MSIP、富國、西藏源樂晟及 CICC Financial Trading Limited(與西藏源樂晟場外掉期有關)、工銀理財、Wind Sabre、豪威香港，總認購金額 309.8 百萬美元，佔發售股份的概約百分比約為 50%。

#### 1.4 保薦人情況

中金公司

代碼	名稱	首日收盤漲跌幅(%)
----	----	------------

3986. HK	兆易創新	37.53
0501. HK	豪威集團	16.22
6938. HK	瑞博生物	41.63
0100. HK	MINIMAX-WP	109.09
2513. HK	智譜	13.17
6082. HK	壁仞科技	75.82
6651. HK	五一視界	29.90
3696. HK	英矽智能	24.66
2635. HK	諾比侃	363.75
2661. HK	輕鬆健康	158.82
2581. HK	明基醫院	-49.46
3881. HK	希迪智駕	-13.69
2676. HK	納芯微	-4.31
9609. HK	海偉股份	-22.97
2685. HK	量化派	88.78
2788. HK	創新實業	32.76
2698. HK	樂舒適	25.95
0800. HK	文遠知行-W	-9.96
0699. HK	均勝電子	-8.00
9927. HK	賽力斯	0.00
2718. HK	明略科技-W	106.10
6687. HK	聚水潭	23.86
2575. HK	軒竹生物-B	126.72
2889. HK	博泰車聯	53.58
9973. HK	奇瑞汽車	3.80
2525. HK	禾賽-W	9.96
2580. HK	奧克斯電氣	-5.40
3858. HK	佳鑫國際資源	177.84
6960. HK	雙登股份	31.29
2631. HK	天岳先進	6.40
2591. HK	銀諾醫藥-B	206.48
6887. HK	東陽光藥	
2590. HK	極智嘉-W	5.36
1304. HK	峰岬科技	16.02
2648. HK	安井食品	-5.00
9678. HK	雲知聲	44.59
6168. HK	週六福	25.00
2050. HK	三花智控	-0.13
3288. HK	海天味業	0.55
2605. HK	METALIGHT	-30.26
2621. HK	手回集團	-18.19
2565. HK	派格生物醫藥-B	-25.90

---

2603. HK	吉宏股份	39.06
2629. HK	MIRXES-B	28.76
3750. HK	寧德時代	16.43
1333. HK	博雷頓	38.33
3677. HK	正力新能	1.45
6681. HK	腦動極光-B	3.42

## 二、業務定位與市場環境

### 2.1 業務定位：PCB 專用設備全工序解決方案龍頭

公司專注於 PCB 專用設備的研發、生產和銷售，產品覆蓋鑽孔、曝光、成型、檢測等關鍵工序，是全球產品線最廣泛的 PCB 設備企業之一。核心產品中，鑽孔類設備為主要收入來源。

### 2.2 技術優勢與行業地位

公司憑藉近 20 年在高速高精運動控制、雷射技術、影像處理等領域的積累，產品性能已達行業先進水準，連續 11 年位列 CPCA 中國電子電路行業百強（專用設備類）第一名。核心技術包括高厚徑比鑽孔方案、高精度背鑽技術等，可滿足 AI 伺服器、高速交換機等高端 PCB 的加工需求，加速對德國 Schmoll、日本三菱等進口設備的替代。

### 2.3 AI 算力驅動行業高景氣，國產替代空間廣闊

全球 AI 算力中心建設推動高多層板、HDI 板需求爆發，帶動 PCB 專用設備市場擴容。Prismark 預測，2024-2029 年全球 PCB 設備市場規模年複合增長率達 8.6%，2029 年將達 113.88 億美元。其中，AI 伺服器相關 PCB 對設備精度、效率要求顯著提升，催生高端鑽孔、鐳射加工設備需求。國內 PCB 設備市場長期由海外巨頭主導，但公司憑藉性價比優勢與快速回應能力，逐步實現進口替代。2024 年公司國內市占率達 10.1%，全球市占率 6.5%，其中鑽孔設備市占率超 30%。隨著下游客戶擴產（如方正科技、勝宏科技），公司在高端市場的份額有望進一步提升。

## 三、財務與經營情況

綜合損益及其他全面收益表概要方面，截至 2025 年 10 月 31 日止十個月公司收入為 43.14 億元，毛利率為 31.1%，期內利潤為 5.19 億元。按 PCB 生產工序的收入方面，鑽孔設備收入為 30.96 億元，占比 71.8%，毛利率為 28.2%；曝光設備收入為 2.48 億元，占比 5.7%，毛利率為 38.7%；檢測設備收入為 3.84 億元，占比 8.9%，毛利率為 40.8%；成型設備收入為 2.38 億元，占比 5.5%，毛利率為 25.7%；貼附設備收入為 0.95 億元，占比 2.2%，毛利率為 39%；其他收入為 2.54 億元，占比 5.9%，毛利率為 47.5%。

## 四、公司發展戰略

### 4.1 技術研發：聚焦 AI PCB 與高端工藝

公司針對 AI PCB 特徵參數微縮、結構複雜等特點，開發超高厚徑比鑽孔方案、高精度背鑽方案等，2025 年前三季度研發投入 3 億元，占營收 7%。截至 2025 年 10 月，公司擁有多項專利，技術成果覆蓋鐳射鑽孔、LDI 曝光等核心領域。

### 4.2 產能擴張：應對高端設備需求

為滿足 AI 驅動的訂單增長，公司增加 PCB 專用設備生產基地（如深圳寶安區新增場地），提升高端設備交付能力。

### 4.3 全球化佈局：H 股上市與東南亞拓展

公司通過港交所上市聆訊，擬募集資金用於海外市場建設（如新加坡生產基地），2024 年境外收入達 3.62 億元（占比 10.8%），六軸機械鑽孔機等產品在泰國、越南等東南亞市場已取得訂單，同步受益於 PCB 產業轉移趨勢。

## 五、投資亮點與風險

### 5.1 投資亮點

#### 5.1.1 全球 PCB 設備龍頭地位穩固，市占率持續領先

公司是全球產品線最廣泛的 PCB 專用設備企業，覆蓋鑽孔、曝光、成型、檢測等關鍵工序，連續 11 年位列 CPCA 中國電子電路行業百強（專用設備類）第一名。按 2024 年收入計，中國市占率 10.1%、全球市占率 6.5%，穩居行業第一，頭部客戶覆蓋全球 PCB 百強企業 80%，客戶粘性強。

#### 5.1.2 AI 算力驅動業績爆發，增長動能強勁

全球 AI 算力中心建設推動高多層板、HDI 板需求激增，帶動 PCB 設備市場擴容。

#### 5.1.3 技術壁壘深厚，國產替代加速

近 20 年技術沉澱形成高速高精運動控制、雷射技術等核心優勢，鑽孔設備獲“單項冠軍產品”認證，曝光設備鐳射直接成像技術接近國際領先水準，持續替代德國 Schmoll、日本三菱等進口設備。

### 5.2 投資風險

#### 5.2.1 行業競爭加劇，毛利率承壓

---

全球 PCB 設備市場分散（前五大廠商市占率 23.9%），海外巨頭技術領先（如 Orbotech LDI 設備線寬優勢），國內同業加速追趕。公司綜合毛利率從 2022 年 34% 降至 2024 年 27.2%，2025 年前三季度回升至 31.1%，但價格競爭可能導致盈利波動。

### 5.2.2 客戶集中度較高，訂單依賴下游擴產節奏

2024 年前五大客戶收入占比超 20%，下游 PCB 廠商擴產節奏受 AI 伺服器需求、宏觀經濟影響較大。若雲廠商資本開支放緩或行業週期性調整，可能導致設備訂單增速下滑。